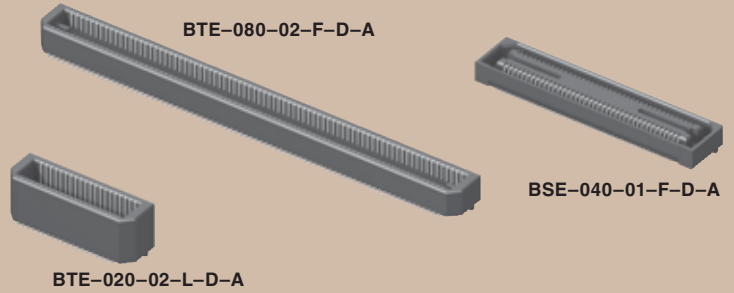




**(0,80mm) .0315"**

**BTE, BSE 系列**



# 基础端子条和插座条

## 技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 [www.samtec.com?BTE](http://www.samtec.com?BTE) 或 [www.samtec.com?BSE](http://www.samtec.com?BSE)

绝缘体材料: 液晶聚合物  
触点材料: 磷铜  
电镀: 在 50µ" (1,27µm) 的镍上镀金或锡



额定电流: 2A @ 80°C 环境和 5mm 堆叠高度  
工作温度范围: -55°C 至 +125°C  
额定电压: 225 VAC 和 5mm 堆叠高度  
最大循环数: 100  
符合 RoHS 规范要求: 是

## 加工:

可无铅焊接: 是  
SMT 引线共面度: 最大 (0,10mm) .004" (020-080) 最大 (0,15mm) .006" (100-120)  
电路板相叠: 对于每板或不少于 80 个位置需要超过两个连接器的应用, 请发邮件至 [ipg@samtec.com](mailto:ipg@samtec.com)

## 堆叠高度

引线式样	堆叠高度*
-01	(5,00) .197
-02	(8,00) .315

\*加工条件将影响配接高度。

## 特殊应用选项

- 30µ" (0,76µm) 镀金
- 边缘封装能力
- 磨擦锁紧选择
- 11mm、14mm、16.10mm、19.10mm、22mm、25mm 和 30mm 堆叠高度 (注意: 有些自动置放/检验设备可能对组件高度有限制。请参考设备规范。)

请致电 Samtec。

\*注: -C 电镀已通过十年 MFG 测试

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

**BTE**

配接: BSE

每排位置数

**-020, -040, -060, -080, -100, -120**

引线式样

从图表中指定引线式样

引线式样	A
-01	(4,27) .168
-02	(7,21) .284

电镀选项

**-F**  
= 触点闪镀金, 尾端镀雾锡

**-L**  
= 10µ" (0,25µm) 触点镀金, 尾端镀雾锡

**-C\***  
= 选择性电抛光 触点区信号针脚的 150µ" (3,81µm) 的镍底上至少 50µ" (1,27µm) 镀金, 触点区接地面 50µ" (1,27µm) 的镍底上至少 10µ" (0,25µm) 镀金, 所有焊接尾端至少 50µ" (1,27µm) 的镍底上镀雾锡

**D**

**A**

其他选项

**-K**  
= (7,00mm) .275" 直径 聚酰亚胺薄膜取放垫

**-TR**  
= 卷带封装 (最多 60 个位置)



**BSE**

配接: BTE

每排位置数

**-020, -040, -060, -080, -100, -120**

引线式样

**01**

电镀选项

**-F**  
= 触点闪镀金, 尾端镀雾锡

**-L**  
= 10µ" (0,25µm) 触点镀金, 尾端镀雾锡

**-C\***  
= 选择性电抛光 触点区信号针脚的 150µ" (3,81µm) 的镍底上至少 50µ" (1,27µm) 镀金, 触点区接地面 50µ" (1,27µm) 的镍底上至少 10µ" (0,25µm) 镀金, 所有焊接尾端至少 50µ" (1,27µm) 的镍底上镀雾锡

**D**

**A**

其他选项

**-TR**  
= 卷带封装 (最多 80 个位置)